

タブレット端末分解装置取扱説明

準備

1. 水平な机上に装置を設置する。
2. 装置本体にレバーを取り付ける。
3. AC100V 電源コンセントにプラグを差し込む。
4. 装置右背後側のカプラプラグにエア供給用ソケットカプラーをセットする。 [画像 1.]
5. 下部吸着スイッチ、上部吸着スイッチが OFF 状態になっていることを確認する。
6. 背面の電源スイッチを ON する。 [画像 2.、画像 3.]
7. 温調器の温度設定 (初期設定: 100℃)は、SV 値 (画面下段赤色表示) を▼ ▲ キーを使って目的の設定値にする。
(警告!! 入力する設定値 (SV) によって制御出力が動作する場合があります。温調器からの出力があっても問題ない事を確認してから入力して下さい。)
8. ヒーターの電源をONする。(前面パネルのデジタル温度調節器 [以下、温調器] の表示が点灯してヒーターの加熱が始まる。)
9. やけど防止用の手袋を用意、装着してから作業を開始して下さい。

作業

1. 上部吸着ユニットを全開にする。
2. 分解するタブレットの画面を下にして、装置固定ガイドの左奥に押し当て、手前の可動ガイドをタブレットのサイズに合わせるように手前から奥にスライドさせセットする。
3. 上部ユニットをタブレットの中心位置にスライド移動させて位置固定ねじでスライドロックをする。
4. 温調器 1.~3.の現状温度(PV)が設定値(SV)に安定表示していることを確認する。 [画像 3.]
5. 下部吸着スイッチを吸着側に倒して、タブレット下面を吸着する。 [画像 4.]
(この時、タブレットを上から軽く押さえて吸着パッドに密着させる)
6. 上部吸着ユニットを閉じて、上部吸着パッドをタブレット背面に密着させる。
7. 上部吸着スイッチを吸着側に倒して、タブレット背面を吸着する。 [画像 4.]
8. 決められた加熱時間が経過したらレバーをゆっくりと下げてタブレットを分解する。 [画像 5.]
9. レバーを下げ切った所で、タブレットが上部と下部に分解された間にスペーサを挿入する。 [画像 6.]
10. 上部吸着スイッチ、下部吸着スイッチを解除側に倒して吸着解除を行う。

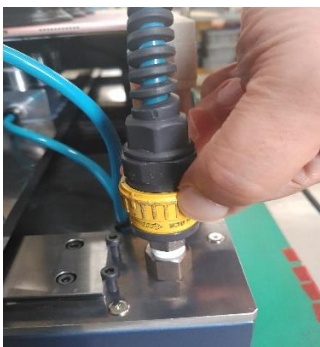
11. 上部吸着スイッチ、下部吸着スイッチを OFF 位置にして吸着解除を終了する。
12. 上部吸着ユニットを全開にする。
13. 分解されたタブレットを取り出す。(必ず、やけど防止用手袋を装着した状態の事。)
14. 作業 6.～作業 14.を繰り返す。

※破壊対象が小さい場合、使用しない吸着パッドの吸気孔にピン(画像 7)で蓋をする。

終了

1. 装着箇所にタブレットがない事を確認後、上部吸着スイッチ、下部吸着スイッチ、ヒータスイッチを OFF 状態にする。
2. 本体背面の電源スイッチを OFF にして温調器 1～3 (表示は、ヒーター1～3)の表示が消灯する。(ヒーターの温度が常温になるまで時間が掛かるので注意！)
3. エアー供給を閉める。
4. 上部吸着ユニットを閉じる。

画像 1.



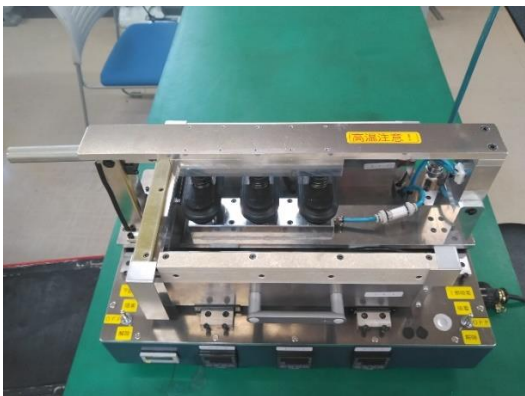
画像 2.



画像 3.



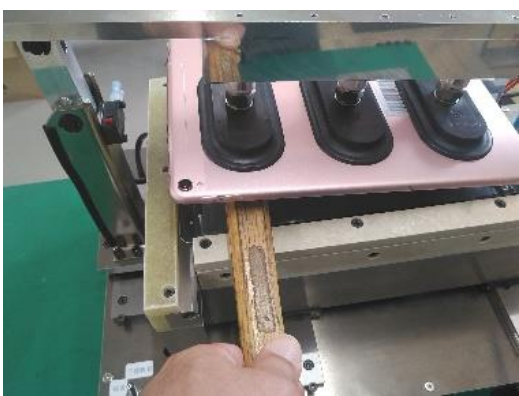
画像 4.



画像 5.



画像 6.



画像 7.

